

## 期刊信息

篇名	Influence of Microstructure on Dielectric Strength of CuCr contact Materials in a Vacuum
语种	英文
撰写或编译	
作者	丁秉钧等
第一作者单位	
刊物名称	IEEE Trans on CPMT
页面	1995.12,Vol.18,No.4
出版日期	1995年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">合金元素和组织对触头合金在真空中电击穿行为的影响</a>